

半导体测厚仪

GP-T-2 系列

高精度光谱共焦测头(上下对射测量)

自带集成式工业电脑, 无需额外配置电脑

圆晶环





高精度测量平台

产品简介

★GP-T-2半导体测厚仪结构紧凑,自带集成式工业电脑,采用高精度大量程光谱共焦测头,该测头高精度、高稳定性,且对于不同材质、不同表面产品具有优异的适用性,使得本品在测量硅片厚度、TTV及弯曲度等参数方便快捷,测量准确。

数据-上	数据-下	厚度	时间	MAX
-00.6090	-00.2060	-00.8152	16:34:41	-0.8146
-00.6335	-00.1819	-00.8154	16:34:42	MIN
-00.6336	-00.1818	-00.8154	16:34:43	-0.8155
-00.6336	-00.1818	-00.8155	16:34:44	AVG
-00.6839	-00.1307	-00.8146	16:34:45	-0.8152
请按空格键开始第1点量测				TTV
				0.0009
				DEV
				0.0003

 重置	 LIVE 取点	厚度/TTV 5点法 模式切换
--	---	-----------------------

技术参数

精度 ¹	± 0.5um	
重复性 ²	± 0.25um	
分辨率	0.1um	
测量项目 ³	厚度(Thickness)/平整度(TTV)/弯曲度(Bow)	
测量范围	晶圆直径 ⁴	50mm - 300mm
	晶圆厚度	100um - 2000um
电压输入(电压):	220VAC	
电压输入(频率):	50 to 60Hz	
使用温度范围:	15 to 40°C	
尺寸(长x 宽x 高):	450*550*550mm	
重量:	约50Kg	
环境要求	温湿度稳定, 环境洁净, 无振动	

- 1.在 22±2°C 恒定的温度下 ;
- 2.在可重复定位的条件下 ;
- 3.平整度(TTV)及弯曲度(Bow)不作为设备验收指标,厚度验证使用标准厚度样件 ;
- 4.对应晶圆规格为2寸-12寸。